

---

# 南亞電路板股份有限公司 2020年營運概況

2021年3月4日



## 免責聲明

---

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



# 議程

---

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



# 公司概況

## 事業簡述

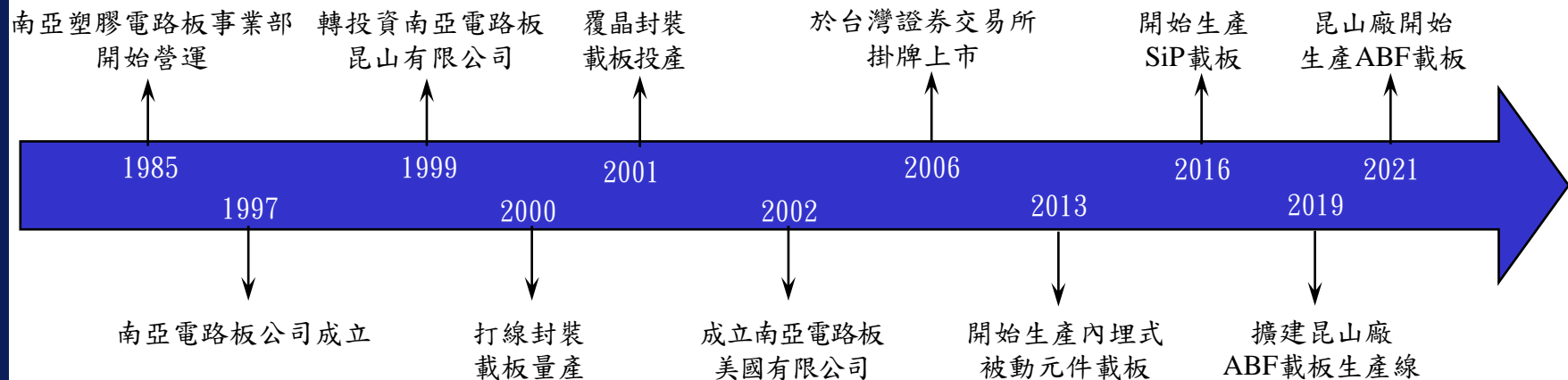
---

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售一般電路板與IC載板
- 2020年合併營業額為新台幣 385.1億元。
- 台股上市市值：新台幣1,176.0億元(2020年12月31日)
- 生產廠區：台灣、大陸



# 公司概況

## 歷史沿革



- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021 : 昆山廠於第一季開始生產ABF載板

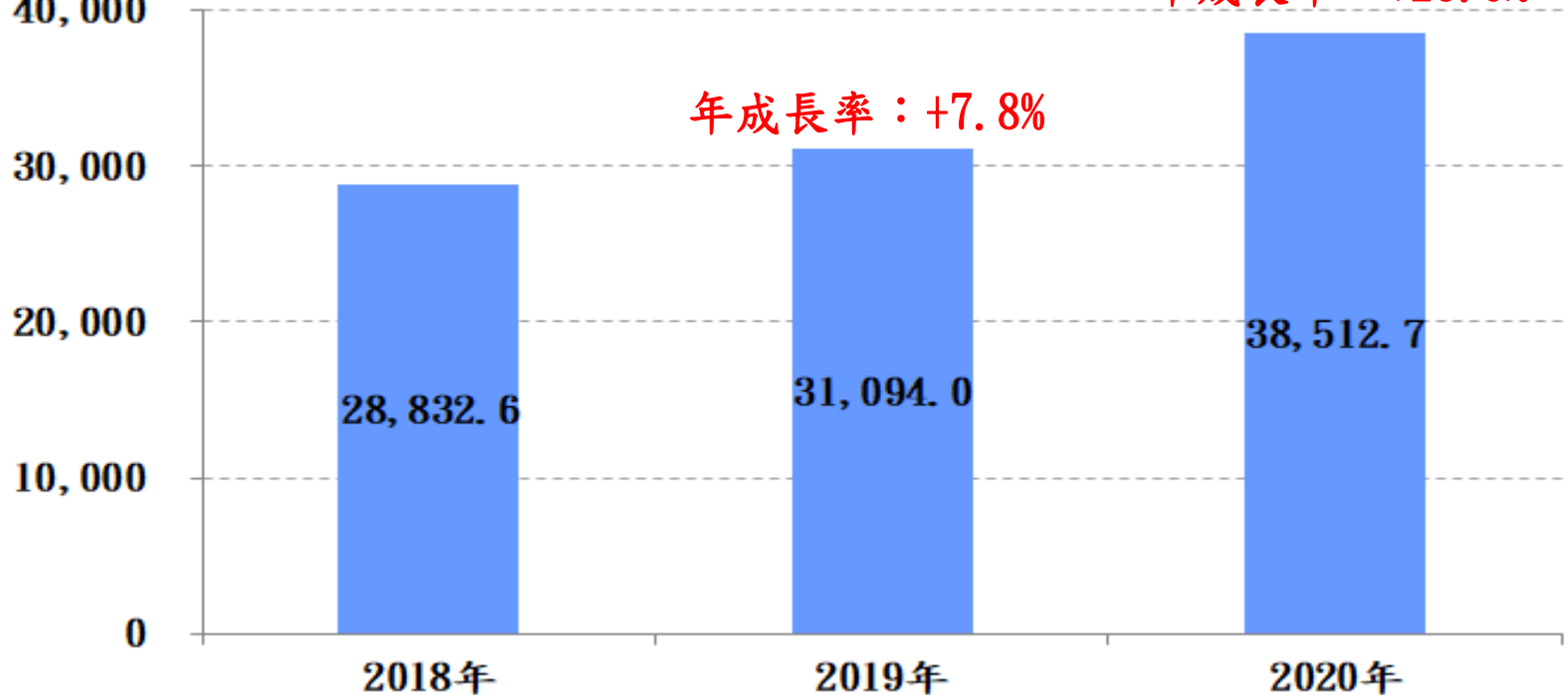


# 財務狀況

## 近三年合併營業收入(IFRS)

(新台幣百萬元)

營業額  
40,000



### ■ 2019營收較2018年增加7.8%:

本公司持續提升高值化產品比重，產品平均單價續揚，使2019年營收比2018年成長。

### ■ 2020營收較2019年增加23.9%:

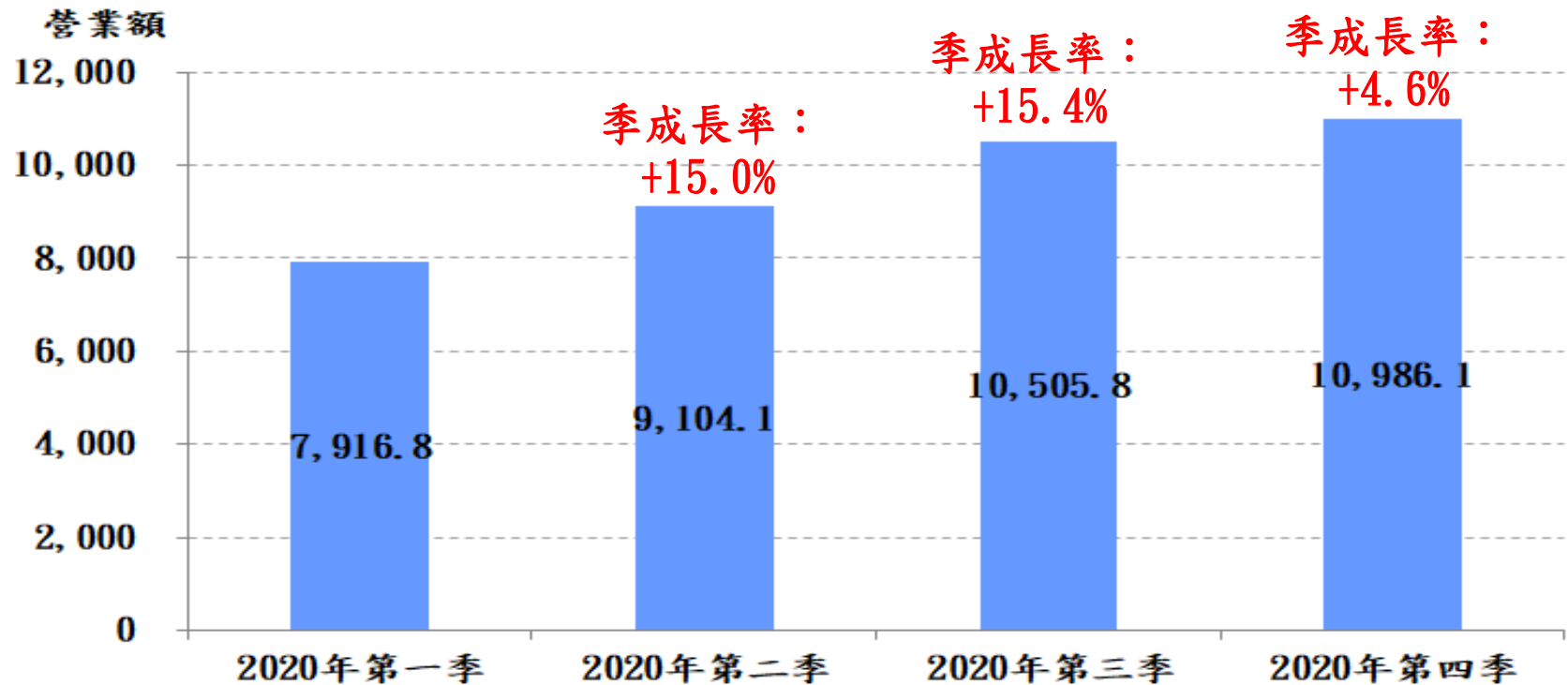
本公司提早佈局高階網通與系統級封裝載板等高值化產品市場，受益於客戶需求提升，2020年營收比2019年顯著成長。



# 財務狀況

## 2020年每季合併營業收入(IFRS)

(新台幣百萬元)



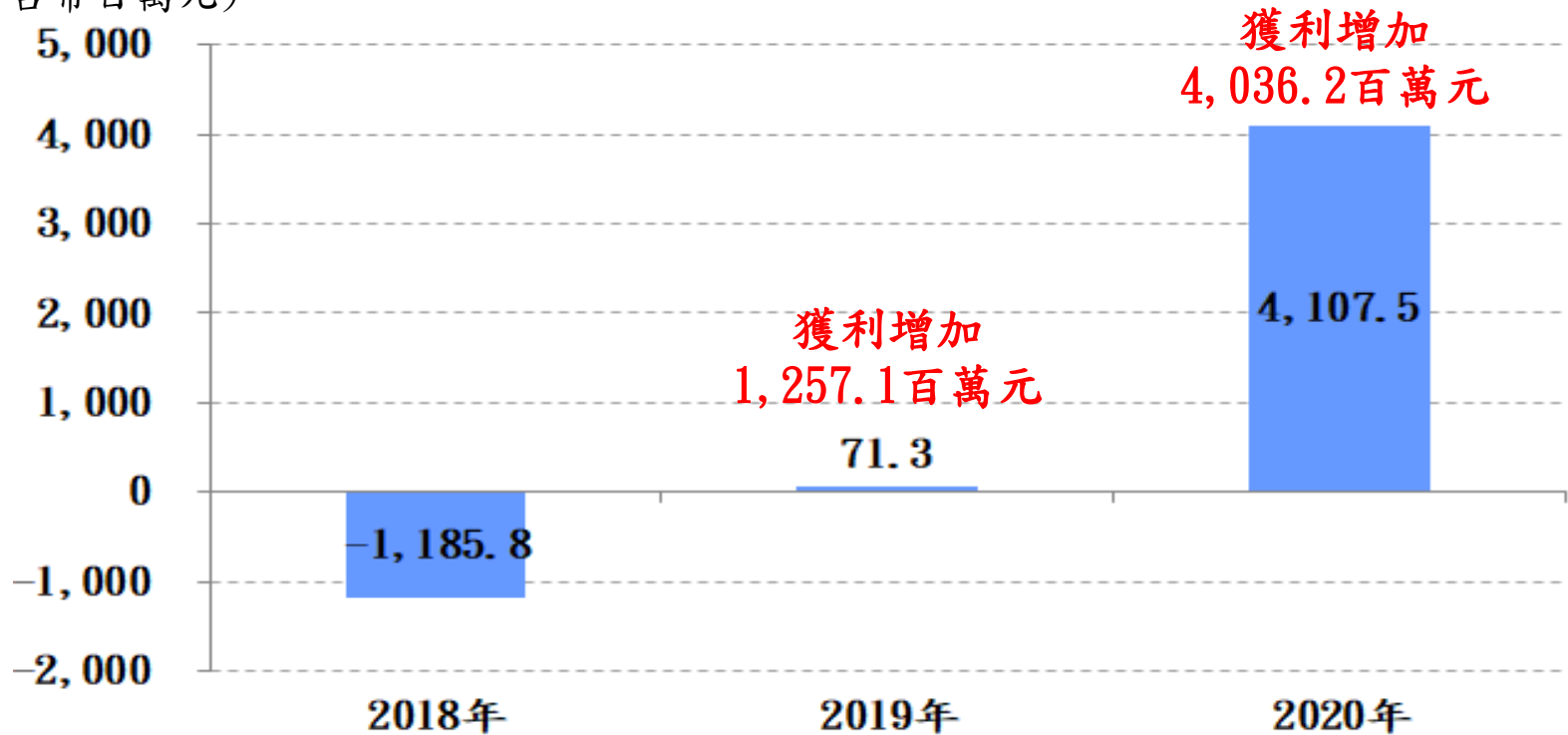
- 2020年第二季營收較第一季增加15.0%：  
2020年第二季擺脫新冠肺炎疫情影響，營收比第一季成長。
- 2020年第三季營收較第二季增加15.4%：  
2020年第三季因網通與消費性電子客戶需求提升，營收持續成長。
- 2020年第四季營收較第三季增加4.6%：  
2020年第四季因電腦、網通及車用產品需求增加，營收進一步成長，達成營收季季增的目標。



# 財務狀況

## 近三年營業利益(虧損)

(新台幣百萬元)



### ■ 2019年營業利益較2018年增加1,257.1百萬元:

本公司2019年高層數大尺寸網通載板等高值化產品銷售佔比持續提升，使2019年營業利益成功轉盈。

### ■ 2020年營業利益較2019年增加4,036.2百萬元:

本公司2020年持續優化製程，提升良率，且在高階網通與系統級封裝產品銷售增加的情況下，2020年營業利益有明顯成長。

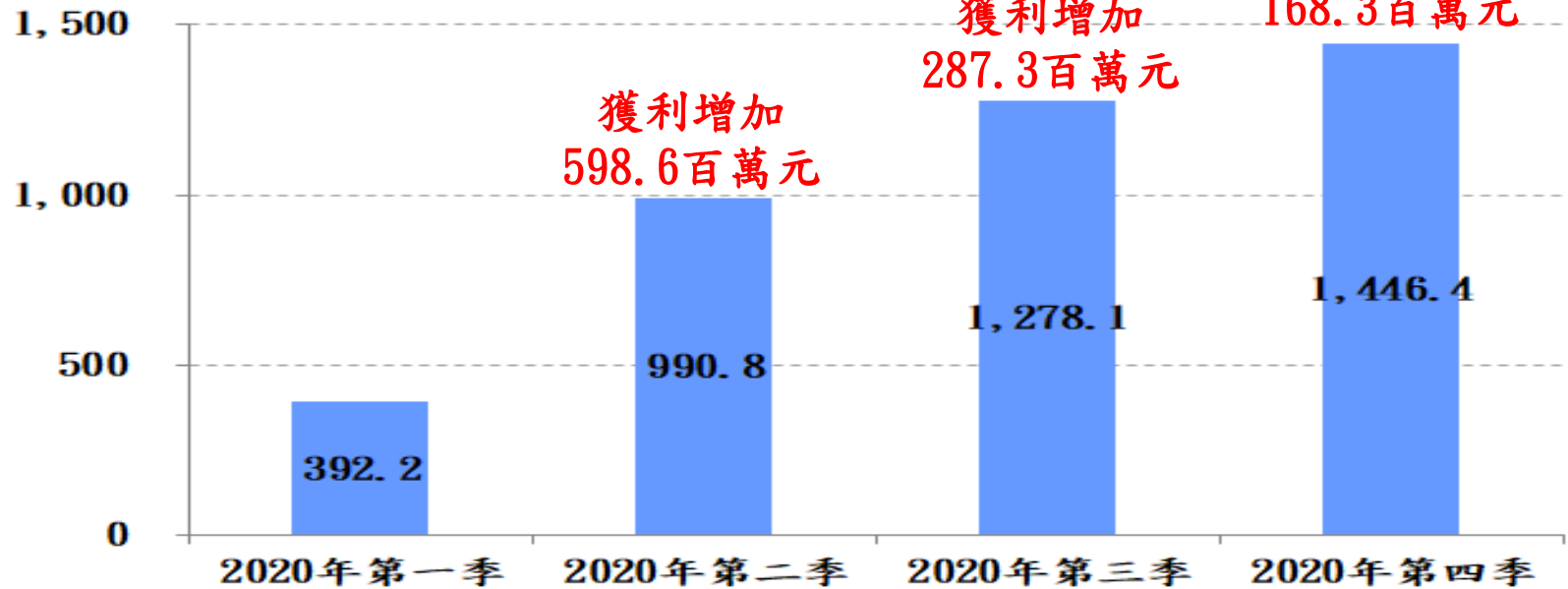




# 財務狀況

## 2020年每季營業利益

(新台幣百萬元)  
營業利益

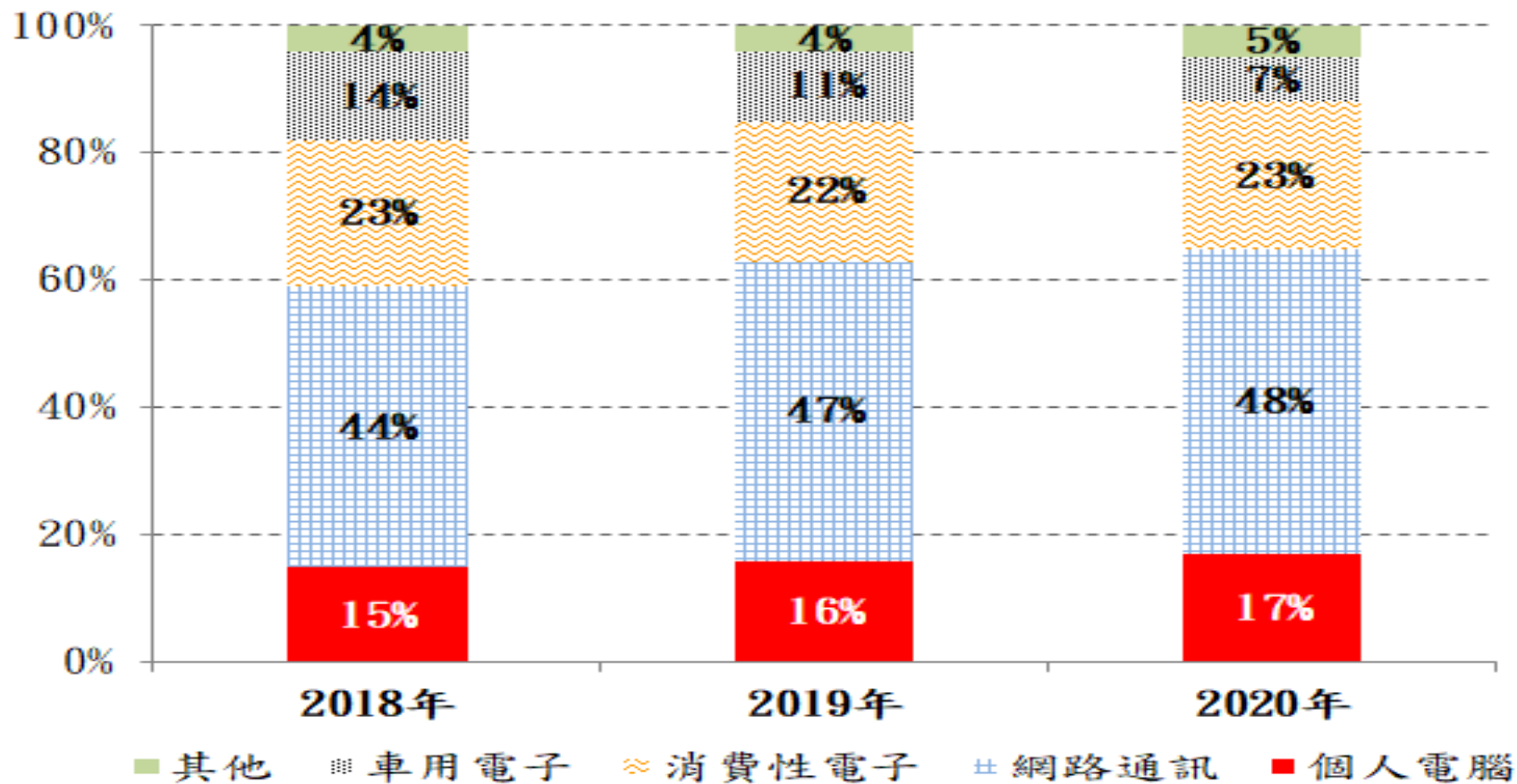


- 2020年第二季營業利益較第一季增加598.6百萬元：  
因高階IC載板需求顯著提高，故第二季比第一季獲利提升。
- 2020年第三季營業利益較第二季增加287.3百萬元：  
因高階網通、系統級封裝載板及中介板等High Value產品出貨量增加，故第三季獲利持續增加。
- 2020年第四季營業利益較第三季增加168.3百萬元：  
除高階網通需求持續增加外，筆記型電腦、遊戲機及車用電子等應用產品銷售暢旺，帶動第四季獲利成長，並達成營業利益季季增的目標。



# 財務狀況

## 營業收入結構(應用別)

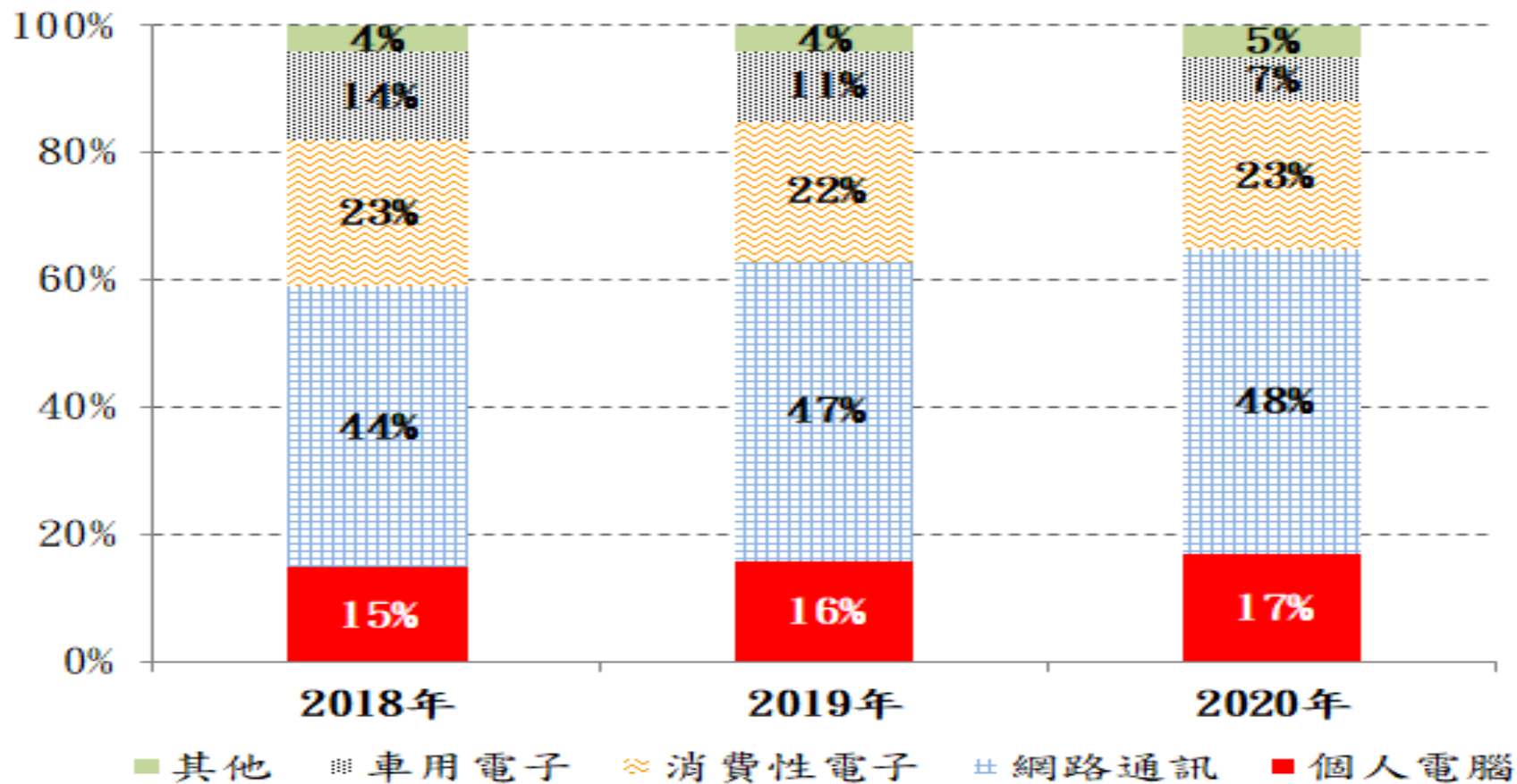


- 本公司個人電腦、網路通訊產品受益於遠距商務需求增加，比重持續提高。
- 受益於高階真無線藍芽耳機熱銷與新世代遊戲機推出，本公司消費性電子應用產品比重提升。



# 財務狀況

## 營業收入結構(應用別)



- 因新冠肺炎嚴重衝擊2020年上半年汽車銷售，即使下半年車用電路板需求逐漸回溫仍無法抵銷其影響，致2020年汽車應用產品營收比重下滑。
- 本公司積極爭取人工智慧與高效運算等高值化產品訂單，故2020年相關產品營收比重持續增加。



# 產品未來發展方向

## 持續拓展高值化產品

### ■ 高階ABF載板

2021年除持續布局高階網通載板市場外，人工智慧與高效運算應用產品銷售亦可望大幅增加；此外，預期遠距商務與宅經濟等需求依舊強勁，亦將配合客戶積極擴張市占率，持續量產高階處理器與繪圖晶片載板。

### ■ SiP載板

因IC異質晶片封裝發展趨勢不變，系統級封裝(SiP)技術將大量應用在各項行動裝置，本公司除持續量產新世代穿戴裝置與高階手機相機模組之SiP載板外，亦將視產能情況，適時切入5G手機天線模組(AiP)，SiP載板銷售可望大幅增加。

### ■ 高密度連接板(HDI)

伴隨行動裝置、消費性及車用電子等產品設計愈趨精密，高平均單價之HDI使用量持續增加，本公司今年將配合筆記型電腦需求成長與汽車市場回溫，量產新世代記憶體、固態硬碟及車用資訊娛樂系統等應用產品，以提高獲利。



# 未來營運目標

## 公司追求營業利益持續成長

### ■ 2021年上半年獲利可望再成長

在電腦、網通及車用電子需求維持高檔的助益下，相關電路板應用產品銷售可望淡季不淡；此外，自第一季起，昆山廠高階IC載板新產能將陸續投產，預計於第二季全數開出，並以全產全銷為目標，貢獻營收與獲利；同時，將人工智慧導入生產管理，以提升良率與降低生產成本，在軟硬並進的綜效下，預期2021年上半年獲利表現可望比2020年同期成長。

### ■ 2021年追求本業獲利逐季成長

**開源：**本公司將延續2020年策略，持續深耕中央處理器、高階網通、人工智慧及高效運算等高值化產品市場，並積極布局高階車用產品領域；同時，持續去化瓶頸製程，以增加產出，滿足客戶需求。

**節流：**本公司將持續推動製程優化與改善生產流程，以提升產品良率與生產效率，同時推動數位化管理，以提高作業效率，強化營運績效，並以本業獲利逐季成長為目標。



感謝您的聆聽

